

# PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:		) :	Examiner: Not Yet Assigned	AB
DAISHI SAIKI ET AL.		)	Group Art Unit: 1713	- 1
Application No.: 09/897,014		; ;		0+1
Filed: Ju	aly 3, 2001	)		
For:	MULTILAYERED STRUCTURE RESIN MOLDED PRODUCT AND METHOD OF MANUFACTURING MULTILAYERED STRUCTURE RESIN MOLDED PRODUCT		October 23, 2001	17/10/0

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

# **CLAIM TO PRIORITY**

Sir:

Applicants hereby claim priority under the International Convention and all rights to which they are entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following Japanese Priority Applications:

2000-214388, filed July 14, 2000

2001-167194, filed June 1, 2001

RECEIVED

Certified copies of the priority documents are enclosed 0CT 2 6 2007

TC 1700

Applicants' undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

tterney for Applicants

Registration No. \_\_\_\_

48,512

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza New York, New York 10112-3801 Facsimile: (212) 218-2200

NY\_MAIN 210052 v 1

TC 1700

- 2 -

(translation of the front page of the priority document of Japanese Patent Application No. 2000-214388)



# PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: July 14, 2000

Application Number : Patent Application 2000-214388

Applicant(s) : Canon Kabushiki Kaisha

August 3, 2001
Commissioner,
Patent Office

Kouzo OIKAWA

Certification Number 2001-3069442

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 7月14日

出 願 番 号
Application Number:

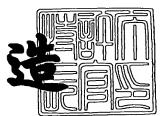
特願2000-214388

出 願 人
Applicant(s):

キヤノン株式会社

2001年 8月 3日 O

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕



【書類名】

特許願

【整理番号】

4254004

【提出日】

平成12年 7月14日

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

B32B 27/00

B29C 45/16

B29C-45/28

【発明の名称】

多層構造の樹脂成形品及び多層構造の樹脂成形品の製造

方法

【請求項の数】

26

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】

佐伯 大志

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】

浦木 泉

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】

松久 裕英

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【氏名】

熊谷 直久

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】

御手洗 富士夫

【電話番号】

03-3758-2111

【代理人】

【識別番号】

100090538

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社

内

【弁理士】

【氏名又は名称】

西山 恵三

【電話番号】

03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】

100096965

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会

社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 内尾 裕一

【電話番号】

03-3758-2111

【選任した代理人】

【識別番号】 100110009

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会

社内

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木 康

【電話番号】

03-3758-2111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

011224

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9908388

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多層構造の樹脂成形品及び多層構造の樹脂成形品の製造方法【特許請求の範囲】

【請求項1】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品。

【請求項2】 前記樹脂成形品は事務機器、電気機器、情報通信機器等の外装部品、筐体部品又は構成部品であることを特徴とした請求項1記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項3】 前記コア層を構成する樹脂材料は事務機器の外装品または事務機器の筐体、構成部品の樹脂成形品を粉砕加工処理した樹脂材料であることを特徴とした請求項2記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項4】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記樹脂成形品を成形する金型のキャビテイ内に射出する前記コア層を構成する樹脂材料の粘性を、前記スキン層を構成する樹脂材料の粘性より低く設定して成形するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法

【請求項5】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用し、前記コア層を構成する樹脂材料の樹脂温度を前記スキン層を構成する樹脂材料の樹脂温度よりも高く設定して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項6】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料と前記スキン層を構成する樹脂材料の夫々の射出時の単位時間当たりの射出体積をコア層樹脂材料をスキン層樹脂材料より大きく設定して成形するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項7】 前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を原料として使用したことを特徴とした請求項6記載の多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項8】 コア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料を成形用金型に夫々射出して多層構造の樹脂成形品を製造する方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した樹脂成形品を粉砕加工し、粉砕した樹脂材料の大きさを所定の大きさに基準設定した樹脂材料を原料として使用したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項9】 前記多層構造の樹脂成形品は画像形成装置の外装部品、筐体部品又は、構成部品であることを特徴とした請求項8記載の多層構造の樹脂成形品の製造方法。

「請求項10」 前記コア層樹脂材料として使用する粉砕樹脂材料の粉砕材料の大きさ寸法は10mm以下の基準に設定されていることを特徴とした請求項9記載の多層構造の樹脂材料の製造方法。

【請求項11】 コア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料を夫々成形用金型に射出して多層構造の樹脂成形品を製造する方法であって、前記スキン層を構成する樹脂材料を所定容量射出後、樹脂材料の成形品を粉砕処理したコア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成するバージンの樹脂材料を同時に射出し、その後、バージンのスキン層を構成する樹脂材料を射出するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項12】 前記コア層樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工したスキン層樹脂材料と同種の樹脂成形品を粉砕加工処理した材料を使用することを特徴とした請求項11記載の多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項13】 前記コア層を構成する樹脂材料として使用する粉砕樹脂材料は成形用金型に射出する溶融状態にする前工程では加熱処理していない状態で使用したことを特徴とした請求項4乃至12記載の多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項14】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉

砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を 使用するとともに、前記スキン層を構成する樹脂材料は前記粉砕加工した樹脂材料と同種の樹脂材料を使用して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成 形品。

【請求項15】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品は機器の外観部品として該機器に装着し、前記スキン層の外観表面からの厚さ寸法を前記コア層樹脂材料部分の透過を抑える数値範囲に規定したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品。

【請求項16】 前記機器は画像形成装置であり、前記樹脂成形品は画像形成装置の外装部品であることを特徴とした請求項15記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項17】 前記樹脂成形品におけるスキン層の厚さ寸法を0.3mm以上に規定したことを特徴とした請求項15又は16記載の多層構造の樹脂成形品

【請求項18】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記スキン層樹脂の成形部分の色の明度 【外1】

L\*

が55以上のとき、前記スキン層樹脂成形部の外観部分の肉厚を0.3mm以上に 規定したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品。

【請求項19】 前記スキン層樹脂成形部の着色成分に顔料を含むことを特徴とした請求項18記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項20】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品はその一部に他の部品を取り付ける取り付け個所を備え、前記樹脂成形品全体には前記コア層とスキン層の多層構造と成し、前記取り付け個所をスキン層樹脂材料で構成するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品。

【請求項21】 前記取り付け個所は弾性特性を備える結合部であることを

特徴とした請求項20記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項22】 前記取り付け個所はねじ結合部であることを特徴とした請求項18記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項23】 前記多層構造の樹脂成形品の前記コア層を構成する樹脂材料は樹脂成形品を粉砕処理した再生処理による樹脂材料であることを特徴とした請求項20万至22記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項24】 前記結合部の肉厚寸法を樹脂成形品の基板部の肉厚寸法より小さく設定したことを特徴とした請求項20記載の多層構造の樹脂成形品。

【請求項25】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品に他の部品と結合する結合部を備える該樹脂成形品の製造方法において、前記樹脂成形品の前記結合部の周囲に薄肉部を設けるようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法。

【請求項26】 前記結合部の肉厚寸法が前記基板部の肉厚寸法より厚い場合に、前記結合部の高さ寸法を基板部の肉厚寸法より規定値以上の高さにした部位を備えていることを特徴とした請求項20乃至23記載の多層構造の樹脂成形品。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は樹脂成形品を成形する樹脂材料をコア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料から成る多層成形構造とした樹脂成形品に関する。

[0002]

特に、コア層樹脂材料の成形部分をスキン層樹脂材料の成形部分で包み込んだ構成の、所謂、サンドイッチ構造の成形に関する。

[0003]

更に、本発明は、熱可塑性樹脂材料を成形加工して樹脂成形品とした樹脂材料 を再利用した樹脂成形品に関する。

[0004]

又、本発明は、前記熱可塑性樹脂材料の成形品を粉砕処理して、該粉砕した樹

脂材料を射出成形加工の樹脂原料とする技術に関する。

[0005]

更に、本発明は熱可塑性樹脂成形品を粉砕処理し、該粉砕処理した樹脂材料を コア層を構成する樹脂材料と、スキン層を構成する樹脂材料を射出成形して多層 成形構造の樹脂成形品とする場合に、前記コア層を構成する樹脂材料に、該粉砕 した樹脂材料を原料として使用した樹脂成形品の製造方法に関する。

[0006]

さらに本発明は、複写機、プリンターなどの画像形成装置、ファクシミリ、コンピュータなどの情報通信機器、家庭電化機器等に使用されているプラスチック 樹脂材料のリサイクル技術に関する。

[0007]

【従来の技術】

射出成形技術の1つに、2種類の樹脂材料を成形用金型のキャビテイに射出してコア層を構成する樹脂成形部分と、スキン層を構成する樹脂成形部分とから成る多層構造の成形加工、所謂、サンドイッチ構造の射出成形がある。

[0008]

前記サンドイッチ成形に関する先行技術は国際特許分類 IPC B29C 45 /16、B29C45/16 等に区分され、例えば、特許第3017052号 公報 、特開平8-224754号公報、等 多くがある。

[0009]

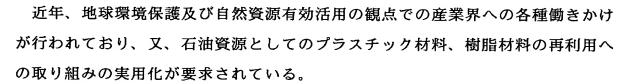
又、本発明は成形加工されたプラスチック材料、樹脂材料を再利用する技術に関するものであるが、樹脂材料の再利用に関する先行情報に関しては、特開平5-301222号公報、特開平5-147036号公報、特開平10-202694号公報 等がある。

[0010]

特許番号第3031357号公報には、再生材をサンドイッチ成形品の芯材と して使用し、更に、表面材にも再生材を使用する例が記載されている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】



[0012]

それに答える意味で、樹脂成形品のリサイクル技術の開発活動が活発化している。

[0013]

中でも、複写機、プリンター、等の画像形成機器、ファクシミリ、コンピュータ、等の事務機器、情報通信機器、又、エアコン、ビデオデッキ、オーデイオコンポなどの家庭電器製品を始めとする各種の電子機器群の製品には比較的大量の大型形状の熱可塑性プラスチック材料が数多く使用されている。

[0014]

これらの製品の使用済み製品から取り外した熱可塑性プラスチック材料は機械強度、難燃性、外観色などの様々な物性値が劣化している。

[0015]

又、表面には様々な異物が付着し汚染されている。

[0016]

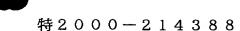
従って、これらの材料に対するリサイクル方法として、成形品を粉砕、洗浄、 再ペレット化を行った後、未使用樹脂材料(バージンペレット)と上記の使用済 みの樹脂材料とを一定の割合で混合して物性を回復する処置を講じて使用する方 法が提案されている。

[0017]

しかしながら、上記の方法においては、劣化した使用済みの樹脂材料を未使用の樹脂材料に混入するために、製造された再生材料は機械強度、難燃性、外観色などの点で、100%バージンペレットの樹脂材料の成形品に比して劣っている

[0018]

先述した資源を有効活用し、産業廃棄物を出来るだけ軽減して環境問題への解 決の糸口のために、使用済み樹脂材料を樹脂成形品の材料に活用するための手段





の1つとして、多層構造成形、所謂、サンドイッチ成形の利用がある。

[0019]

即ち、上記多層成形品はコア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂 材料を成形用金型に射出して断面部分が、コア層をスキン層で覆う多層構造の樹 脂成形品と成すものである。

[0020]

この、多層構造のコア層樹脂材料に前記使用済みの樹脂材料を利用する方法である。

[0021]

上記多層構造成形、所謂、サンドイッチ成形加工の樹脂材料の原料に使用済み 樹脂材料を再使用して樹脂材料のリサイクル率を上げるためには、リサイクル材 料としてのコア層樹脂部分の充填率が重要となる。

[0022]

コア層構造部分の充填量を増やし、該コア層構造部分の周囲にスキン層樹脂材料を多く射出すると、スキン層部分の被覆部分からコア層樹脂がはみ出してしまうことになる。

[0023]

本発明の課題の他の1つは、成形品全体にコア層樹脂材料が均一にかつ、出来 るだけ多くの量が充填され、更に、コア層樹脂部分がスキン層樹脂材料で完全に 覆われていることであり、このような、成形品及び、製造方法を提案することに ある。

[0024]

又、本発明の課題の1つは、再利用する樹脂成形品を粉砕処理したコア層部分の樹脂材料の機械強度、難燃性、外観色 などの物性値を変化させることのなく 材料コストのメリットを図る製造方法を提案する。

[0025]

又、本発明の課題は再生材をサンドイッチ成形(多層成形構造)のコア材に使用して上記の問題の解決の糸口とする場合に派生する、再生材の物性値の劣化対策にある。





[0026]

即ち、前記した複写機、プリンター、ファクシミリ等の、画像形成機器、情報通信機器の構成部品である、外装品、筐体、機構部品などは平板構造に加えて、 他の部品との連結作用を行うネジ部、嵌め込み部などの機能部を構成している。

[0027]

そして、そのような機能部は機械的強度を保証する必要があるが、コア材に再生材を使用すると、再生材の物性値の劣化による前記機能部の機能保証を得ることが困難であった。

[0028]

更に、本発明の課題の1つは、再生材を多層構造成形品のコア材に使用した場合の外観構造部品の成形品とした状況での品質保証上の問題がある。

[0029]

即ち、再生材は前記した物性値の劣化のみならず、成形した場合の外観上の色、の退色上の問題を含んでおり、コア層に再生材を使用し、その表面のスキン層として未使用バージン材を使用した場合に、コア層の再生材の退色した色が外観上への悪影響を防ぐ対策が必要となる。

[0030]

更に、本発明の課題解決のためにスキン層樹脂成形部分とコア層樹脂成形部分 からなるサンドイッチ成形構造とした場合、外観上の問題が発生する。

[0031]

即ち、コア層樹脂材料に粉砕処理した再生材の樹脂材料の色が濃色(明度の低い色)を採用すると、スキン層樹脂の色の明度Lが明るい色の場合、コア層樹脂の明度が低く、スキン層樹脂材料の成形部分の厚さが薄いと、成形品の外観上の不具合が生じる。

[0032]

【課題を解決するための手段】

本発明は上記課題を解決するために、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料

はバージン材料を使用して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品を提案する。

[0033]

上記発明には、前記樹脂成形品が事務機器、電気機器、情報通信機器等の外装部品、筐体部品又は構成部品であることを特徴とした請求項1記載の多層構造の 樹脂成形品の態様がある。

[0034]

更に、前記コア層を構成する樹脂材料の原料は事務機器の外装品または事務機器の筐体、構成部品の樹脂成形品を粉砕加工処理した樹脂材料であることを特徴とした請求項2記載の多層構造の樹脂成形品の態様がある。

[0035]

本発明の1つは、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記樹脂成形品を成形する金型のキャビテイ内に射出する前記コア層を構成する樹脂材料の粘性を前記スキン層を構成する樹脂材料の粘性より低く設定して成形するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法により上記課題を解決する。

[0036]

更に、本発明の1つはコア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用し、前記コア層を構成する樹脂材料の樹脂温度を前記スキン層を構成する樹脂材料の樹脂温度を前記スキン層を構成する樹脂材料の樹脂温度よりも高く設定して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法を提案する。

[0037]

本発明は、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料と前記スキン層を構成する樹脂材料の夫々の射出時の単位時間当たりの射出体積をコア層樹脂材料をスキン層樹脂材料より大きく設定して成形するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法を提案する。

[0038]

上記発明には、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工 した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を使用したことを特徴とした請求項6記載の 多層構造の樹脂成形品の製造方法の態様がある。

[0039]

又、本発明の他の1つは、コア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料を成形用金型に夫々射出して多層構造の樹脂成形品を製造する方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した樹脂成形品を粉砕加工し、粉砕した樹脂材料の大きさを所定の大きさに基準設定した樹脂材料を使用するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法を提案する。

[0040]

前記多層構造の樹脂成形品は画像形成装置の外装部品または筐体部品、構成部 品であることを特徴とする。

[0041]

前記コア層樹脂材料として使用する粉砕樹脂材料の粉砕材料の大きさ寸法は10 mm以下が好ましく、特に4~10 mmの範囲に基準設定されている態様を提案する。

[0042]

又本発明は、コア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料を夫々成形用金型に射出して多層構造の樹脂成形品を製造する方法であって、前記スキン層を構成する樹脂材料を所定容量射出後、樹脂材料の成形品を粉砕処理した樹脂材料をコア層を構成する樹脂材料と成し、バージン材のスキン層を構成する樹脂材料を同時に射出し、その後、バージン材のスキン層を構成する樹脂材料を射出するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法を提案する

[0043]

前記コア層樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した樹脂成形品を粉砕加工 処理した材料を使用することを特徴とした請求項11記載の多層構造の樹脂成形 品の製造方法の態様がある。

[0044]

前記コア層を構成する樹脂材料として使用する粉砕樹脂材料は成形用金型に射 出する溶融状態にする前工程では加熱処理していない状態で使用した。

[0045]

更に本発明の他は、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用するとともに、前記スキン層を構成する樹脂材料は前記粉砕加工した樹脂材料と同種の樹脂材料を使用して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品を提案する。

[0046]

本発明の1つは、前記課題の1つの、外観上の問題点対策として、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品は機器の外観部品として該機器に装着し、前記スキン層の外観表面からの厚さ寸法を前記コア層樹脂材料部分の透過を抑える数値範囲に規定したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品を提案する。

[0047]

上記発明の態様には前記樹脂成形品におけるスキン層の厚さ寸法を0.3mm以上に規定したことを特徴とした請求項16記載の多層構造の樹脂成形品がある。

[0048]

更に本発明の1つは、前記した多層構造成形品の機能部の強度保証対策として、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品はその一部に機能部品を取り付ける個所を備え、前期樹脂成形品全体には前記コア層とスキン層の多層構造と成し、前記機能部品取り付け個所をスキン層樹脂材料で構成するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品を提案する。

[0049]

本発明は上記の樹脂成形品を機構構造部材として使用する場合に、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品はその一部に他

の部品を取り付ける取り付け個所を備え、前記樹脂成形品全体には前記コア層と スキン層の多層構造と成し、前記取り付け個所をスキン層樹脂材料で構成するよ うにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品を提案する。

[0050]

前記取り付け個所は弾性特性を備える結合部であることを特徴とした請求項2 0記載の多層構造の樹脂成形品の態様を提案する。

[0051]

更に、前記取り付け個所はねじ結合部であることを特徴とした請求項20記載の多層構造の樹脂成形品の態様を提案する。

[0052]

前記多層構造の樹脂成形品の前記コア層を構成する樹脂材料は樹脂成形品を粉砕処理した再生処理による樹脂材料である。

[0053]

又、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品に他の部品と結合する結合部を備える該樹脂成形品の製造方法において、前記樹脂成形品の前記結合部の周囲に薄肉部を設けるようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法を提案する。

[0054]

【発明の実施の形態】

以下に図面を参照して本発明の各実施例について説明する。

[0055]

(第一実施例)

図1は本発明の対象成形品である、多層成形構造成形品を外装部品1とした場合の該外装部品の斜視図。

[0056]

図2は図2A-A線の断面の要部説明図である。

[0057]

図3は前記図1,2に示す多層成形構造部材1を射出成形する成形機の要部構成を示す説明図である。

[0058]

図において、符号2は固定型板部材、4は可動型板部材、6は固定型板部材2に取り付けた固定側金型駒部材、8は可動型板部材4に取り付けた可動側金型駒部材、10は固定側金型駒部材6と可動側金型駒部材8に形成した成形品形状を表すキャビティである。

[0059]

12は固定側の取り付け板部材、14は可動側の取り付け板部材。

[0060]

16は突き出し固定板、18は突き出し板部材、20はスペーサーブロック部材、22はエジェクターピンである。

[0061]

24は跳ね出し板部材、26はランナーロックピン、28はロケートリング、30は不図示の射出シリンダーのノズル受け部、32はノズル、34はスプール、36はランナー、38はゲート部を夫々示す。

[0062]

40はガイドピンである。

[0063]

42は前記ノズルに接続させて樹脂材料のコア層樹脂材料とスキン層樹脂材料を夫々射出する射出手段であり、該射出手段は、例えば、特許第3017052号、特開平8-224754号、特開平9-52256号などの公報に開示されている装置を採用することができる。

[0064]

本発明に係る樹脂材料の原料となるコア層構造部分の材料は、例えば、複写機 やレーザービームプリンターの使用済み回収製品の分解過程で、前記外装部品1 又は、該外装部品と同じ樹脂材料の成形部品を集積し、該成形部品1を分解、粉 砕、洗浄、分級処理した材料を再生材として使用するものである。

[0065]

スキン層樹脂材料は未使用のバージン樹脂材料を使用する。

[0066]

図4は本発明の原料となるコア層樹脂材料の再生システムの構成を示す図である。

[0067]

前記回収された複写機、レーザービームプリンターの外装部品1を粉砕機50 により所定の大きさに粉砕する。

[0068]

前記外装部品1の樹脂材料はポリカーボネイト樹脂(PC)と、アクリルニトリル、ブタジエン、スチレン(ABS)のアロイ成形樹脂材料を使用している。

[0069]

本例においては粉砕のサイズは4~10mmに設定した。

[0070]

該粉砕寸法の設定数値範囲は粉砕処理したコア層樹脂材料の原料を可塑化装置のホッパーに供給する際のホッパー又は搬送供給過程での目詰りを考慮して規定した。

[0071]

粉砕された原料は搬送装置52によって所定量ずつ振動櫛54に送られる。

[0072]

56は回収タンクであり、粉砕されない材料を再度粉砕機に戻す。

[007.3]

58は微粉末回収タンク。

[0074]

振動櫛54を通過した粉砕材料は磁気分別機60により金属部分の除去作業が 行われる。

[0075]

磁気分別機60を通過した材料はホッパ62、フイダー64を経由して洗浄機66に送られる。

[0076]

洗浄機66で洗浄された粉砕樹脂原料は洗浄脱水機68を介して空送ブロワー70によりサイクロン72に供給される。

[0077]

74は洗浄液の濃度調整工程であり、76は循環装置である。

[0078]

サイクロン72に送られた粉砕樹脂材料は風力分級機78により分級され、比重の小さい異物はブロワー80により回収タンク82に排出される。

[0079]

分級された粉砕樹脂材料は再度、磁気選別機84に通されブロワー86により ストックタンク88に供給される。

[0080]

その後、金属分離機90により分離された金属類は回収タンク92に送られる

[0081]

金属などの不純物を取り除かれた粉砕樹脂材料は再生プラスチック材料として 回収容器94に回収される。

[0082]

(成形操作の説明)

次に、本発明に係る多層樹脂成形品の製造プロセスについて図 5 を参照して説明する。

[0083]

第一実施例の成形条件は前記固定側成形金型駒部材6及び可動側成形金型駒部材8のキャビティ表面温度は不図示の加熱手段により60 ℃±1 ℃ に設定される。

[0084]

スキン層樹脂材料の射出時の温度は250℃、

コア層樹脂材料の射出時の温度は 270℃、

スキン層樹脂材料の射出速度は 10 mm/sec

コア層樹脂材料の射出速度は 20 mm/sec である。

[0085]

上記設定条件において、コア層樹脂材料の射出温度をスキン層樹脂材料の射出

設定温度より高い温度粋に設定して、コア層樹脂材料の粘性をスキン層樹脂材料 の粘性より低く設定してある。

[0086]

スキン層樹脂材料のPC+ABS樹脂材料は可塑化手段42(図3)の第一のシリンダ内で加熱溶融状態に成り、又、コア層樹脂材料の前記図5に示す処理工程で粉砕処理された再生樹脂材料も第二のシリンダ内で加熱溶融状態に成る。

[0087]

図5に示すように、まず、第一射出工程としてスキン層樹脂材料が可塑化手段 4 2 から所定時間 T 1 内に所定の樹脂量 Q 1 が射出される。

[0088]

続いて、第二射出工程としてスキン層樹脂材料とコア層樹脂材料が所定時間の T2内にスキン層樹脂材料の容量Q2、コア層樹脂材料の容量P1が同時に射出 される。

[0089]

この第二射出工程において、第一射出工程で先に、キャビテイ内に射出された スキン層樹脂材料は第二射出工程で該スキン層樹脂材料とコア層樹脂材料に押し 出されるようにキャビテイ内の周壁に沿うようにキャビテイ内を進む。(図7参 照)

[0090]

第二射出工程に続いて、スキン層樹脂材料が所定時間T3に所定量Q3が第三工程として射出される。

[0091]

前述したように、スキン層樹脂材料の射出温度はコア層樹脂材料の射出温度よりも低く設定してあるので、先にキャビテイ内に射出されたスキン層樹脂材料の 後側を第二射出工程で射出されたコア層樹脂材料がスキン層樹脂材料を押し出す ようにキャビテイ内を進行し、キャビテイ表面にはスキン層樹脂材料が満弁なく 行き渡るように成形される。

[0092]

図6は図5の各射出工程でキャビティ内に射出される樹脂材料の状態を模式化

した状態を説明する図面であり、第一射出工程でスキン層樹脂材料のみが射出され、第二工程ではスキン層樹脂材料と再生材料のコア層樹脂材料が同時に射出され、キャビテイ内では図6に示すように、コア層樹脂材料をスキン層樹脂材料が包むように射出される。

[0093]

このように、第二の射出工程で、コア層樹脂材料がスキン層樹脂材料で包まれるように射出されるので、コア層樹脂材料がスキン層樹脂材料を突き破るような 状態に成ることを避けることができる。

[0094]

図7は本実施例の上記射出工程操作による成形品の断面図を示し、スキン層樹脂材料とコア層樹脂材料の射出充填状態を示す断面図である。

[0095]

(第二実施例)

図8万至図15を参照して本発明の第二の実施例について説明する。

[0096]

本例は樹脂成形品の他の部品との連結/結合機能を作用する機能部分を構成する例を示す。

[0097]

複写機、プリンター、レーザービーム プリンタ (LBP)等の画像形成装置、ファクシミリ、コンピュータ、通信回線機器、携帯通信機器等の情報/通信機器の外装品や、構成部材を強度と軽量化に対応するためにプラスチック樹脂材料による成型品とする場合が多いが、これらの外装品、構成部材には他の部品との連結/結合機能を作用するための取り付け部を形成する場合がある。

[0098]

例えば、図8、図9に示す、ばね結合のための多層構造の樹脂成形品の基板部 100から一体的に成形された弾性突起部(爪部)102や、ねじ結合のための 突起部104である。

[0099]

これらの弾性突起部102、突起部104は相手側の結合部材との機械的結合

作用のために弾性特性や靭性が要求される個所である。

#### [0100]

しかしながら、本発明の課題である、樹脂材料のリサイクル化による、又、樹脂材料の有効活用のための、コア層樹脂材料を樹脂成形品を粉砕処理した再生原料材を採用しようとすると、再生樹脂材料は未使用のバージン樹脂材料に比して機械的特性、特に、靭性特性の劣化が見られる。

#### [0101]

そのため、上記のような多層構造樹脂成形品に他の部材との連結/結合作用を行う機能部分を備える構造部材とするには不適当であった。

#### [0102]

図8において、弾性突起部102の肉厚寸法t1を基板部100の肉厚寸法T1より薄くすることで弾性突起部102を構成するキャビテイ内への樹脂材料の回りこみをスキン層樹脂材料のみになるようにし、コア層樹脂材料の流入を阻止するように成し、粉砕処理原料によるコア層樹脂材料の靭性特性の劣化による影響を回避することができる。

#### [0103]

図9において、ねじ結合のための突起部104の肉厚t2を基板部100の肉厚T2より薄くすることで突起部104の構成樹脂材料をスキン層樹脂材料のみで成形することができ、突起部の靭性、弾性を確保することができた。

#### [0104]

図10は平板状の多層構造樹脂成形品を成形する場合に、ゲート位置を該平板 を形成するキャビテイの略中心位置に設定した場合の射出樹脂材料の流動状態を 模式的に示す図である。

#### [0105]

多層構造の樹脂成形は、最初に、スキン層樹脂材料を射出し、続いてコア層樹脂材料を射出することで、前記図2に示したように成形品の表面層をスキン層樹脂材料で構成するようにしたものであるが、本例においては、前記連結/結合機能部分をキャビテイ内の樹脂材料の流動末端位置に設定することで、該機能部分への樹脂材料の回りこみをスキン層樹脂材料のみで構成することができる。

[0106]

図11、図12は前記機能部を弾性作用させるばね突起部102の弾性機能を 更に保証させるための樹脂成形品100の構造を示す。

[0107]

図11、12において、前記ばね突起部が植立する基板平面部100の近傍位置の周囲に溝部100Aを形成することで、該溝部近傍の平板を形成するキャビテイ部分の隙間が狭隘に構成され、これによってコア層樹脂材料の流動性が低下し、その結果、ばね突起部102にはスキン層樹脂材料のみになり、コア層樹脂材料の流入阻止が保証される。

[0108]

図12は図11のb-b方向断面図であり、基板100の厚さ寸法T3に対し て溝部の深さ寸法t3を規定することによりコア層樹脂材料の流入量の調整が図 られる。

[0109]

図13、図14はねじ結合機能部104の場合を示す。

[0110]

この場合も、ねじ結合部104の植立する基板平面の近傍周囲を薄肉形状に成すために、基板部分100を構成するキャビテイを狭隘にしてコア層樹脂材料の流動が阻止されるように構成してある。

[0111]

図15はセルフタップボス部106を形成する例を示す。

[0112]

この場合も、ボス部106をスキン層樹脂材料のみで成形することでねじ結合の機械強度を保証することができる。

[0113]

特に、寸法的には、ボス部106の高さ寸法H2を基板部108の肉厚寸法T6の3倍以上の設定することでコア層樹脂材料の流入を阻止し、スキン層のみの構成にすることができた。

[0114]

# (第三実施例)

本発明はコア層樹脂材料の原料として成形品を粉砕処理した材料を再ペレット 化による物性値を回復させずに再利用することでリサイクル効率、環境資源対策 に寄与することを主題とするものである。

#### [0115]

その場合、コア層樹脂材料として使用する粉砕処理した樹脂材料は、成形品と しての使用年月の経過期間に応じて、表面の外観色の変色、退色が生じている。

# [0116]

したがって、コア層樹脂成形部分をスキン層樹脂成形部で包む多層構造成形品とする場合、コア層樹脂成形部分の色、例えば、コア層樹脂成形部分が黄ばんでいたり、変色したりしていると、その色の状況がスキン層樹脂成形部分の透過率の関係で表面に現れ、外観上の問題を引き起こすことになる。

#### [0117]

特に、コア層樹脂材料の色が濃色で、スキン層樹脂材料の色の濃度と異なる場合に外観上の問題が生じる。

# [0118]

本実施例はこの問題に対する解決策を講じるものである。

# [0119]

プラスチック樹脂材料の成型品は数年で外観上の変色を来たす製品もその使用環境により応じて存在する。

#### [0120]

色の性質は色の順序の色相、色の鮮やかさの彩度、と色の明度の3つの属性があるが、本明の実施例で取り上げる製品として、複写機、プリンターなどの事務機器製品であるが、これらの製品の外装部品の色は使用環境に悪影響を及ぼさない明度に配慮がなされており、当実施例で採用した製品の場合は白色系統である

# [0121]

本例において、当社製の使用期間2~7年あまりの複写機のプラスチック樹脂 成形品(pc+ABSアロイ樹脂)からなる内装部品を取り外した。 [0122]

樹脂の色は濃いグレー色であった。

[0123]

この内装部品を第一実施例と同様に、粉砕処理してコア層樹脂材料の原料として再利用する。

[0124]

スキン層樹脂材用として、PC+ABSアロイ樹脂のバージンペレットを使用し、前記図1と同じ外装部品として成形加工した。

[0125]

板部の厚さ寸法は2.0mmである。

[0126]

前記成形品を数箇所切断し、各々の断面を工具光学顕微鏡で観察した。

[0127]

その結果、スキン層樹脂材料による成形部分の肉厚は0.55~0.40mmであった。この成形品のスキン層の肉厚が0.40mmの部分の外観色をグレタマクベス社製、積分球分光光度計(CE-7000A)にて測定した。

[0128]

測定結果

[0129]

【外2】

 $(L^*, a^*, b^*) = (77,59.0.53,4.44)$   $var{c}$ 

[0130]

なお、スキン層樹脂成形部分のみの個所を測定した処、

[0131]

【外3】

 $(L^*, a^*, b^*) = (77.72, 0.60, 4.38)$   $rac{7}{7}$ 

[0132]

更に、他の成形個所の測定片を測定した、

スキン層樹脂成形部分の肉厚は0.48~0.30mmであった。

[0133]

そして、スキン層樹脂成形部分の厚さが0.30mmの個所の外観色を測定した。

[0134]

【外4】

 $(L^*, a^*, c^*) = (77.42, 0.51, 4.24)$   $rac{1}{2}$ 

[0135]

更に、成形のスキン層樹脂部分の厚さを薄くして、コア層樹脂材料の充填量を増加する検討を行い、スキン層樹脂部分の肉厚を0.26~0.20mmの条件で成形加工したところ、外観上にコア層樹脂材料の樹脂の色が透けて見えた。

[0136]

そして、外観色を測定した処、次の結果であった。

[0137]

【外5】

 $(L^*, a^*, b^*) = (71.32, 1.02, 0.35)$  rosoto

[0138]

【発明の効果】

本発明に拠れば、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品によりコ s 層樹脂材料の再生利用を図ることができた。

[0139]

又、前記樹脂成形品は事務機器、電気機器、情報通信機器等の外装部品または 、筐体部品とすることにより環境問題への解決点を提案できた。

[0140]

又、本発明は、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記樹脂成形品を成形する金型のキャビテイ内に射出する前記コア層を構成する樹脂材料の成形流動特性を、前記スキン層を構成する樹脂材料の成形流動特性より大きく設定して成形するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法の提案により、サンドイッチ成形技術の多様性を展開することができた。

# [0141]

更に、本発明においては、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品の製造方法であって、前記コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用し、前記コア層を構成する樹脂材料の樹脂温度を前記スキン層を構成する樹脂材料の樹脂温度よりも高く設定して成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法の提案により再利用の樹脂材料による影響を回避させることができた。

# [0142]

又、コア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料を夫々成形用金型に射出して多層構造の樹脂成形品を製造する方法であって、前記スキン層を構成する樹脂材料を所定容量射出後、前記コア層を構成する樹脂材料とスキン層を構成する樹脂材料を同時に射出し、その後、スキン層を構成する樹脂材料を射出するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品の製造方法の提案により再利用樹脂材料の利用率の向上を図ることができた。

#### [0143]

本発明の1つである、コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記樹脂成形品はその一部に他の部品を取り付ける取り付け個所を備え、前記樹脂成形品全体には前記コア層とスキン層の多層構造と成し、前記取り付け個所をスキン層樹脂材料で構成するようにしたことを特徴とした多層構造の樹脂成形品とすることで多層構造の樹脂成形品の機能的用途の拡大を図ることが出来た

# 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る多層樹脂成形品の斜視図。

【図2】

図1のA-A方向断面図。

【図3】

本発明に係る樹脂成形品の成形加工に使用する成形機の要部構成の説明図。

【図4】

本発明に使用するコア層樹脂材料として使用する再生樹脂材料の粉砕処理工程の説明図。

【図5】

多層構造樹脂成形品の製造加工プロセスの説明図。

【図6】

スキン層樹脂材料とコア層樹脂材料の射出工程の説明図。

【図7】

スキン層樹脂材料とコア層樹脂材料の金型キャビテイ内の状態の説明図。

【図8】

多層構造の樹脂成形品の基板面上に他の部品との連結/結合の機能部を 形成した説明図。

【図9】

ねじ結合の場合の説明図。

【図10】

キャビテイ内への樹脂材料の流動状態の説明図。

【図11】

他の例の説明図。

【図12】

図11のb-b方向断面図。

【図13】

他の例の説明図。

# 【図14】

# 図13のC-C方向断面図。

# 【図15】

# 他の例の説明図。

# 【符号の説明】

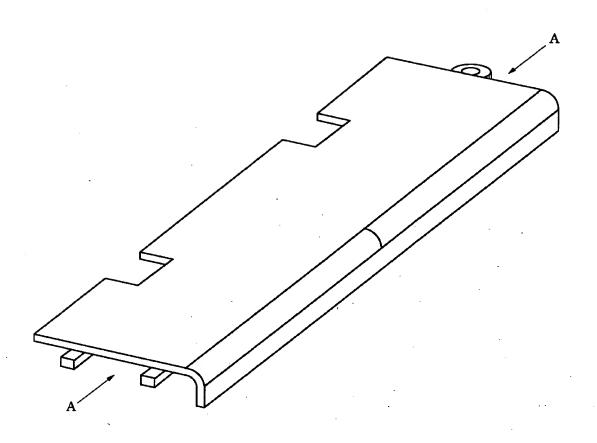
- 1 多層構造の樹脂成形品
- 2 固定型板
- 4 可動型板
- 6 固定側金型駒部材
- 8 可動側金型駒部材
- 10 キャビテイ
- 12、14 取り付け板
- 16 突き出し固定板
- 18 突き出し板
- 20 スペーサーブロック
- 22 エジェクターピン
- 24 跳ね出し板
- 26 ランナーロックピン
- 28 ゲート
- 30 ロケートリング
- 32 ノズル
- 34 スプルー
- 36 ランナー
- 42 可塑化手段
- 50 粉砕機
- 52 搬送装置
- 5 4 振動櫛
- 56 回収タンク
- 62 ホッパ

- 66 洗浄液タンク
- 72 サイクロン
- 88 タンク
- 100 多層樹脂構造成形品
- 102、104 機能部(ばね突起、ねじ突起)
- 100A 溝部

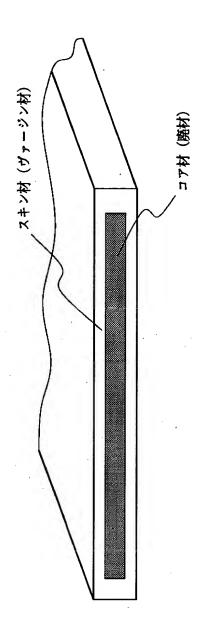
【書類名】

図面

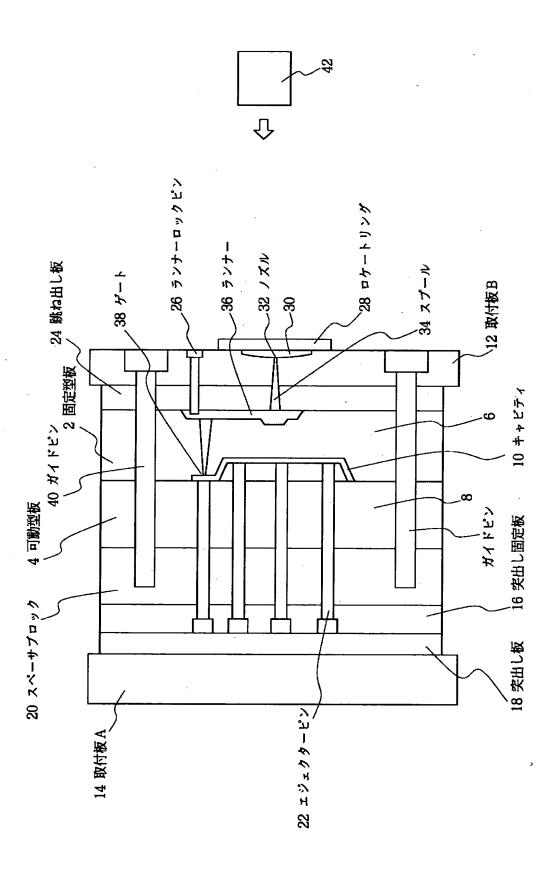
【図1】



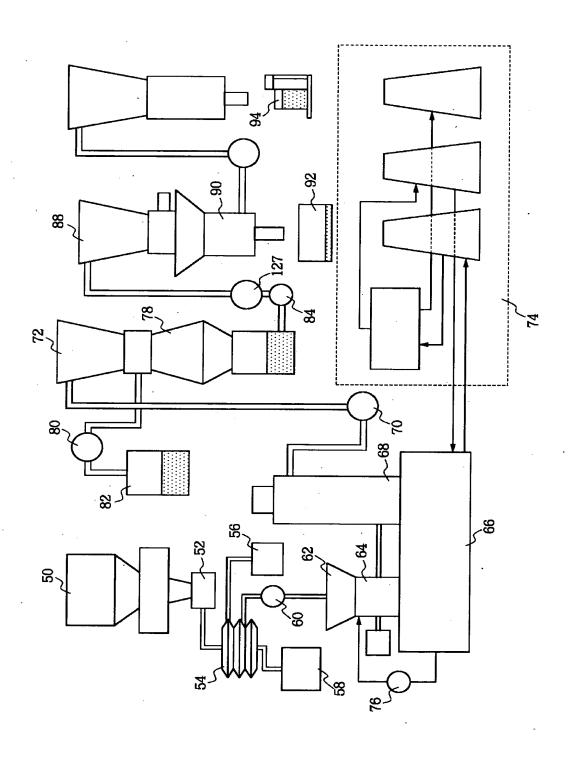
【図2】



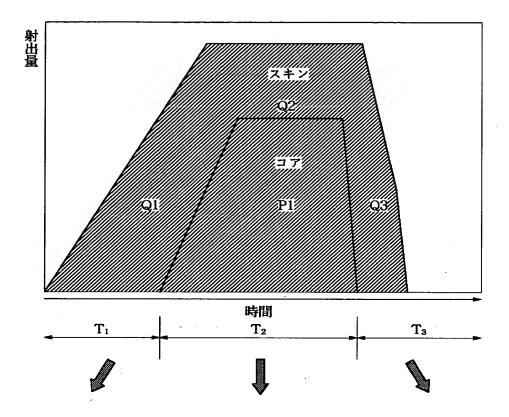
【図3】



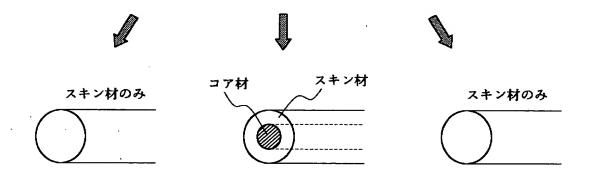
【図4】



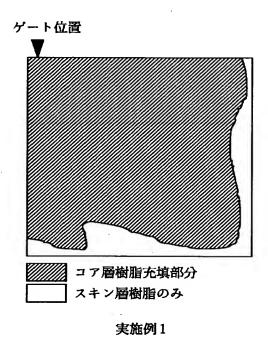
【図5】



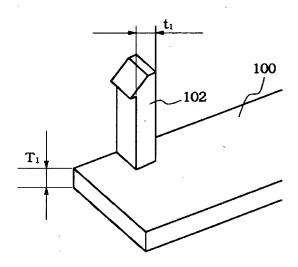
【図6】



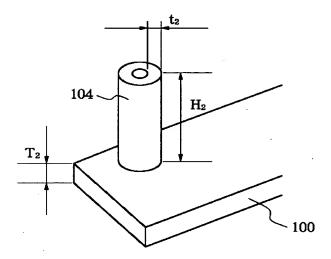
【図7】



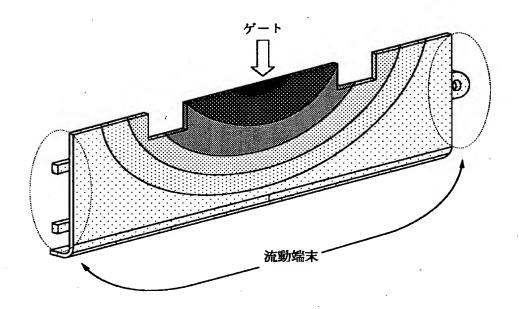
【図8】



【図9】

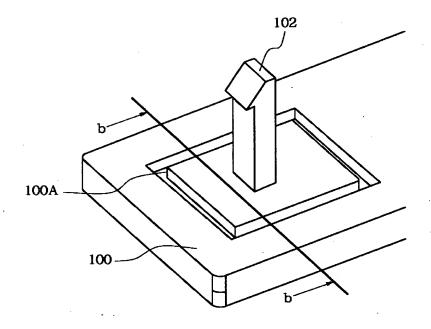


[図10]

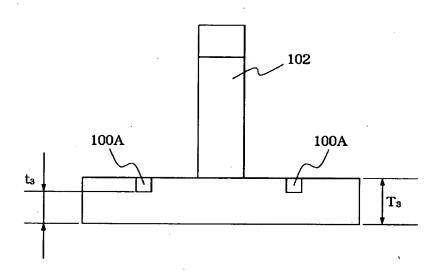




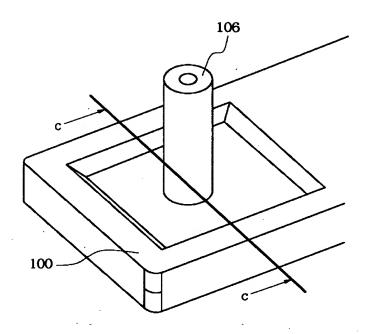
【図11】



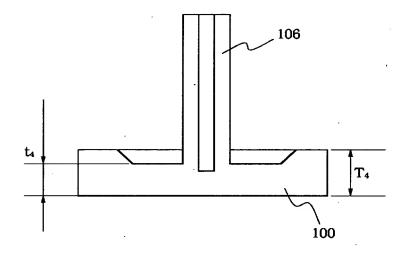






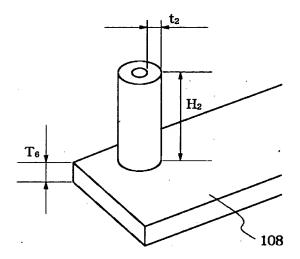








【図15】



## 特2000-214388

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 樹脂成形品の再利用を図る多層康応成形品を提供する。

【解決手段】 コア層とスキン層から成る多層構造の樹脂成形品であって、前記 コア層を構成する樹脂材料は熱可塑性樹脂材料を成形加工した成形品を粉砕した 粉砕樹脂材料を用い、前記スキン層を構成する樹脂材料はバージン材料を使用し て成形加工したことを特徴とした多層構造の樹脂成形品によりコア層樹脂材料の 再生利用を図ることができた。

【選択図】

図 5

## 特2000-214388

## 出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社